




6/10(水) 13:00～ 東京ビッグサイト東 7H セミナー会場 11  
★★ 展示 6/10(水)～12(金) 午前 10 時～午後 5 時 ★★

無料

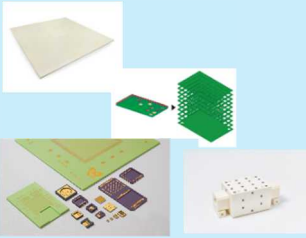
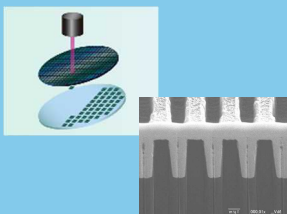


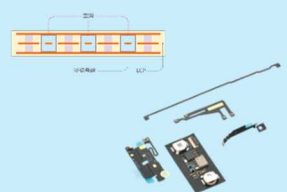
選りすぐりの最先端パッケージング、基板、基板材料を集めました。

他では聞けない**先端技術、オンリーワン技術**の情報収集にご活用下さい！

時間	講師	講演／概要
1300	<p>(株)村田製作所</p> <p>通信・センサ事業本部 通信モジュール事業部 プリンシパルエンジニア</p>  <p>池本 伸郎</p>	<p>「初出展！中空構造で超低損失基板を実現 ULTICIRC」</p> <p>低損失特性を持つ基板メトロサークをさらに進化させ、中空構造によって究極の低損失性能を実現した新製品 ULTICIRC(アルティサーク)を開発。その特徴と次世代通信への応用の可能性を紹介します。</p>
1400	<p>パナソニック インダストリー(株)</p> <p>メカトロニクス事業部 ファインマテリアルビジネスユニット テクノロジーイノベーション総括部 技術二部 開発五課 課長</p>  <p>森田 陽介</p>	<p>「既存 PCB 工程&amp;フィルム型基板材料を活用した プリント配線板の高周波対応・微細化対応」 ～10um 以下の平滑な Cu 回路を 有するプリント配線板製造の新たな選択肢～」</p> <p>プリプレグやビルドアップフィルムといった、従来から広くプリント配線板として活用されている基板材料、及びそのラミネートプロセスを活用しながら、従来製造が難しかった 10um 以下の平滑な Cu 配線を有するプリント配線板を形成するために、当社が開発した「キャリア付き微細配線」という中間部材の活用を提案する。</p>
1500	<p>京セラ(株) ファインセラミック事業本部</p> <p>機構部品事業部 機構部品商品技術部 責任者 本庄 隆人</p> <p>単結晶事業部 技術部商品技術課 商品技術系 梅原 幹裕</p> <p>半導体部品セラミック材料事業本部 半導体部品セラミック材料開発部 設計技術開発部責任者 新納 範高</p> 	<p>「半導体製造装置で使われるファインセラミックスと単結晶サファイア技術」</p> <p>本講演では、会社紹介をはじめ、セラミックの特性・必要性・用途を解説します。併せて、京セラ材料の特徴や製造プロセス、半導体分野での製品事例を紹介し、サファイア基板の性能についてもご説明します。</p> <p>「高度化する顧客ニーズへの統合最適化アプローチ (セラミックパッケージ技術の活用事例)」 ～お客様の課題に寄り添う、最適な選定と設計へのアプローチ～ セラミックパッケージの基礎と、デバイス性能を最大化する活用法を解説します。具体事例を交え、高度化する市場要求に対し必要な設計手法をご紹介します。</p>

出展企業(小間番号)

展示内容

<p>京セラ株式会社 (7C-01)</p>		<p>メタライズ印刷電極ヒーター(550 mm角)、積層技術、単結晶サファイヤ、エアライド、高耐電圧アルミナ材料(AH100A)、ESD 対策用ジルコニア、低誘電正接・高強度・高純度アルミナ、角型ポーラスチャック等、先端パッケージ製造装置に用いられる材料を中心にセラミック技術を展示。また、半導体部品セラミック材料事業本部はセラミックパッケージ全般を展示。 <a href="https://www.kyocera.co.jp/">https://www.kyocera.co.jp/</a></p>
<p>信越化学工業株式会社 (7C-05)</p>		<p>最先端半導体パッケージやチップの高集積化訴求に最先端レーザ装置技術と材料で応えます。超高速・高精度実装機では、マウンター及び FC ボンダーで難易な小型・低背化チップ実装が対応可能。超微細レーザ加工機では、高精度かつ微細なビアや溝(トレンチ)をパッケージ基板・RDL に加工可能。 <a href="https://www.shinetsu-microtech.jp/">https://www.shinetsu-microtech.jp/</a></p>
<p>パナソニックインダストリー株式会社 (7C-03)</p>		<p>独自の微細配線技術を活用した透明導電フィルム「FineX®(ファインクロス)」と、微細配線技術を応用した「FineX® 半導体パッケージ向けキャリア付き微細配線」(開発品)を出展します。同開発品は、線幅 2~10µm の高精度・平滑 Cu 配線形成技術により、高周波特性と実装安定性を両立し、次世代半導体パッケージの進化に貢献します。 <a href="https://www.panasonic.com/jp/industry.html">https://www.panasonic.com/jp/industry.html</a></p>
<p>マクセル株式会社 (7C-04)</p>		<p>創業製品である電池と磁気テープで培った独自のアナログコア技術(混合分散技術・精密塗布技術・高精度成形技術)を活かした全固体電池、EMC 対策部材、および低圧発泡成形技術を展示。あわせて、グループ会社の害獣捕獲監視システム「マタギっ娘」も紹介します。 <a href="https://www.maxell.co.jp/">https://www.maxell.co.jp/</a></p>
<p>株式会社村田製作所 (7C-02)</p>		<p>展示会に初お披露目となる ULTICIRC(アルティサーク)のほか、LCP 多層基板(メトロサーク™)、コンデンサ/インダクタ内蔵基板(iPaS™)を出展します。 <a href="https://www.murata.com/">https://www.murata.com/</a></p>

東京ビッグサイト東7ホール



プログラムは変更する場合があります。予めご了承下さい。  
掲載写真は、各社の許諾を得て使用しています。

来場登録はこちらの QR コードからお願いします。

電子機器2026  
トータルソリューション展

2026.6.10 Wed. - 12 Fri. 10:00-17:00

東京ビッグサイト東展示棟

